

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

LEAD FRAME FORM FOR IC CARD MODULE

Patent Number: JP6092076
Publication date: 1994-04-05
Inventor(s): INOUE AKINOBU; others: 02
Applicant(s):: OKI ELECTRIC IND CO LTD
Requested Patent: ☐ JP6092076
Application Number: JP19920246547 19920916
Priority Number(s):
IPC Classification: B42D15/10 ; G06K19/077 ; H01L23/00 ; H01L23/50
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the adhesion between a lead frame and mold resin for a read/write module used in an IC card so that terminals may not be separated from the mold when the module is bent.
CONSTITUTION:In an island 14 and terminals 15 of a lead frame 13, sectional forms of half etching parts 14a of the island end and half etching parts 15a of the terminal ends are made to be oblique which can be pinched by mold resins 17a and 17b.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-92076

(43) 公開日 平成6年(1994)4月5日

(51) Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 4 2 D 15/10	5 2 1	9111-2C		
G 0 6 K 19/077				
H 0 1 L 23/00				
23/50		A 9272-4M		
		8G23-5L		
		G 0 6 K 19/00		L

審査請求 未請求 請求項の数1(全5頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平4-246547

(22) 出願日 平成4年(1992)9月16日

(71) 出願人 000000295

神電氣工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 井上 明信

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電氣工業株式会社内

(72) 発明者 小村 治文

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電氣工業株式会社内

(72) 発明者 山口 忠士

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 神電氣工業株式会社内

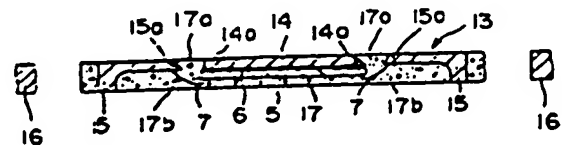
(74) 代理人 弁護士 鈴木 敏明

(54) 【発明の名称】 ICカードモジュール用リードフレーム形状

(57) 【要約】

【目的】 ICカードに搭載される、読み出し/書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、リードフレームとモールド樹脂との密着力を向上させて、モジュールの曲げに対する端子部の剥離耐力を向上させるものである。

【構成】 リードフレーム13のアイランド14および端子15において、そのアイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状を、モールド樹脂17aおよび17bで挟持できる傾斜形状としたものである。



本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ICカードに搭載され、読み出し／書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、

リードフレームのアイランド部および、または端子部のハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できる傾斜形状にしたことを特徴とする ICカードモジュール用リードフレーム形状。

【発明の詳述】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、ICカードに搭載される読み出し／書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 図3は、従来のリードフレーム形状を備えた ICカードモジュールを示す平面図およびその A1-A2 断面図である。図において、1はその詳細な構成を図4に示すように、例えば板厚 0.6mm のリードフレームである。このリードフレーム 1 はアイランド 2、端子 3 および外枠 4 からなっている。5 はリードフレーム 1 のアイランド 2 の下部に、ボンディングシート 6 を介してボンディングした半導体素子、7 は端子 3 と半導体素子 5 間をワイヤボンディングしたボンディングワイヤ、8 はモールド樹脂封止金型にてモールド樹脂境界線 9 内を充填したモールド樹脂、10 はこのモールド樹脂封止金型のエジクトピンである。

【0003】 次に、上記構成のリードフレームの製造工程を図5(a)～図5(c)を参照して説明したのち、ICカードモジュールの製造方法を図3(A)および図3(B)を参照して説明する。まず、図5(A)に示すように、リードフレーム 1 の基材 1a の表面に、リード形状として残した部分にレジスト 11 を塗布する。そして、図5(B)に示すように、矢印 12 の方向からエッチングする。そして、図5(C)に示すように、このレジスト 11 を除去することにより、図4に示すリードフレーム 1 を製造することができる。そして、このリードフレーム 1 のアイランド 2 の下部に、半導体素子 5 をボンディングシート 6 を介してボンディングする。そして、この半導体素子 5 と端子 3 間をボンディングワイヤ 7 によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線 9 内をモールド樹脂 8 で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジクトピン 10 により金型より突き上げて、取り出したのち、仮片化し、図示せぬ ICカード上に実装するものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記構成のリードフレーム形状では、アイランド 2 のハーフエッチング部のアイランド端形状 2a (図5(C)参照) および端子 3 のハーフエッチング部の端子端形状 3a

(図5(C)参照) が R 形状になっているため、リードフレーム 1 とモールド樹脂 8 とは接着力の面で保持されている。このため、(A) モールド成形時、モールド樹脂封止金型内のエジクトピンにて突き上げる際、モールド樹脂と金型との離脱時、モールド樹脂とモールド樹脂封止金型との密着により、モジュールを反らせ、端子部が剥離してしまうこと、(B) モジュールを ICカード上に実装したのち、折り曲げ試験により端子部が剥離し、この剥離により、ワイヤ断線、およびモジュール内へ水分が侵入し、A) 腐食などが発生するという問題点があった。

【0005】 本発明は、以上述べた端子部の剥離によるワイヤの断線および A) 腐食という問題点を除去するため、端子部の断面形状を変えることにより、端子とモールド樹脂との剥離をなくすることができる優れた形状を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明に係る ICカードモジュール用リードフレーム形状は、そのアイランド端ハーフエッチング部および端子端ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できる傾斜形状にするものである。

【0007】

【作用】 本発明は、端子部の剥離耐力を大幅に向上させることができる。

【0008】

【実施例】 図1は本発明に係る ICカードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えた ICカードモジュールを示す断面図である。図において、13はその製造工程を図2(A)～図2(E)に示すリードフレームである。このリードフレーム 13 はアイランド 14、複数個の端子 15 および外枠 16 を備えている。特に、アイランド 14 のアイランド端ハーフエッチング部 14a および端子 15 の端子端ハーフエッチング部 15a の断面形状は、モールド樹脂 17 にて挟持できるように傾斜させて形成したものである。具体的には、アイランド端ハーフエッチング部 14a および端子端ハーフエッチング部 15a で形成された空間に充填されたモールド樹脂 17a と半導体素子 5 側へ充填されたモールド樹脂 17b とによってアイランド 14 および端子 15 の端部を挟持できるように形成される。

【0009】 次に、上記構成のリードフレームの製造工程を図2(A)～図2(E)を参照して説明したのち、ICカードモジュールの製造方法について説明する。まず、図2(A)に示すように、リードフレーム 13 の基材 13a の両表面に、リード形状として残した部分にレジスト 18 を付ける。そして、図2(B)に示すように、基材 13a の一方の表面をエッチングする。そして、図2(C)に示すように、基材 13a のエッチングした部分に、レジスト 19 を付ける。そして、図2

(D)に示すように、母材13aの他の表面をエッチングする。そして、図2(E)に示すように、レジスト18および19を除去することにより、リードフレーム13を製造することができる。このようにして、アイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状は、モールド樹脂17にて挟持できるように傾斜させて形成することができる。そして、このリードフレーム13のアイランド14の下部に、半導体素子5をボンディングシート6を介してボンディングする。そして、この半導体素子5と端子15間をボンディングワイヤ7によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線内をモールド樹脂17で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジェクトピンにより、金型より突き上げて、取り出したのち、割片化し、図示せぬICカード上に実装するものである。

【0010】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状によれば、アイランド端ハーフエッチング部および端子端ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて挟持できるように形成したので、端子部の耐腐蝕力が向上し、

ワイヤ断線やA1腐食の発生を防ぐことができ、品質を向上することができるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えたICカードモジュールを示す断面図である。

【図2】図1のICカードモジュール用リードフレーム形状の製造工程を示す断面図である。

【図3】従来のICカードモジュールを示す平面図および断面図である。

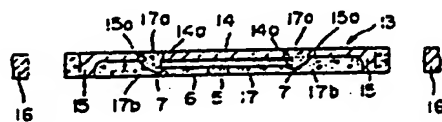
【図4】図3のリードフレームを示す平面図である。

【図5】図3のリードフレームの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

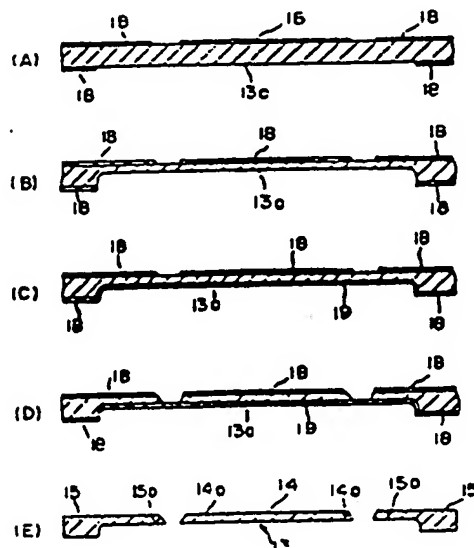
- 5 半導体素子
- 13 リードフレーム
- 14 アイランド
- 15 端子
- 16 外枠
- 17 モールド樹脂
- 18, 19 レジスト

【図1】



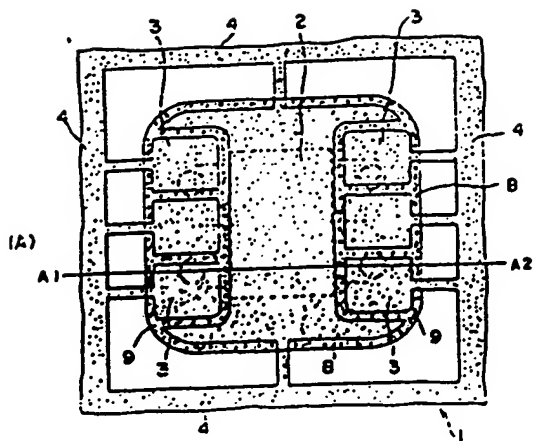
本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

【図2】



本発明のリードフレームの製造工程を示す断面図

[図3]



[図4]

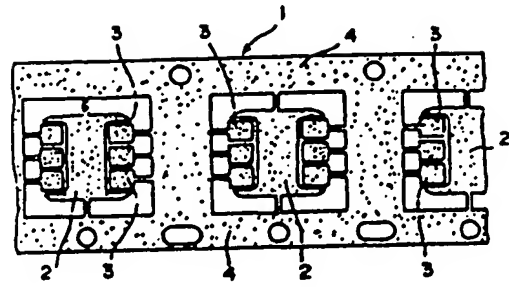


図3のリーフレームの平面図

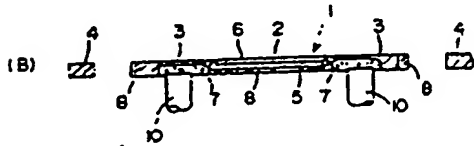


図3のリーフレームの断面図

[図5]

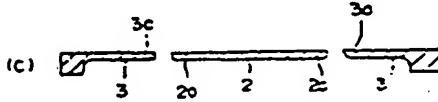
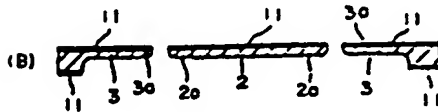
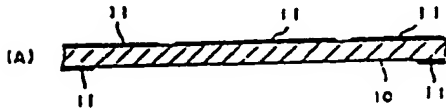


図3のリーフレームの断面図

(5)

特許平6-92076

フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁴
H01L 23/50

識別記号 庁内整理 号 F 1
H 9272-4M

技術表示箇所

(19) 日本国特許庁 (J P)

(2) 公開特許公報 (A)

(31) 特許出願公開番号

特開平6-92076

(43) 公開日 平成6年(1994)4月5日

(51) Int. Cl. ⁴	随別記号	庁内整理番号	F I	技術表示係所
B 4 2 D 15/10	5 2 1	9111-2C		
G 0 6 K 19/077				
H 0 1 L 23/00				
23/50				
	A	5272-4M		
		8623-5L		
			G 0 6 K 19/00	L
審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平4-246547

(22) 出願日 平成4年(1992)9月16日

(71) 出願人 000000295

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 井上 明徳

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気
工業株式会社内

(72) 発明者 小林 治文

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気
工業株式会社内

(72) 発明者 山口 忍士

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気
工業株式会社内

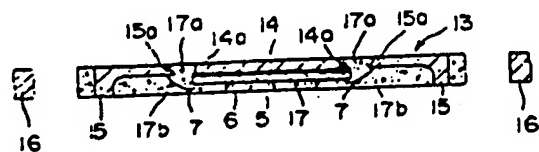
(74) 代理人 弁理士 鈴木 敏明

(54) 【発明の名称】 ICカードモジュール用リードフレーム形状

(57) 【要約】

【目的】 ICカードに搭載される、読み出し/書き込み等の機能を持つモジュールのリードフレーム形状において、リードフレームとモールド樹脂との密着力を向上させて、モジュールの曲げに対する端子部の剥離耐力を向上させるものである。

【構成】 リードフレーム13のアイランド14および端子15において、そのアイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状を、モールド樹脂17aおよび17bで挟持できる傾斜形状としたものである。



本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

(D)に示すように、母材13aの他の表面をエッチングする。そして、図2(E)に示すように、レジスト16および19を除去することにより、リードフレーム13を製造することができる。このようにして、アイランド端ハーフエッチング部14aおよび端子端ハーフエッチング部15aの断面形状は、モールド樹脂17にて支持できるように傾斜させて形成することができる。そして、このリードフレーム13のアイランド14の下側に、半導体素子5をボンディングシート6を介してボンディングする。そして、この半導体素子5と端子15間をボンディングワイヤ7によりボンディングを行なう。そして、モールド樹脂封止金型にて、モールド樹脂境界線内をモールド樹脂17で充填する。そして、モールド樹脂封止金型のエジクトピンにより、金型より突き上げて、取り出したのち、個片化し、図示せぬICカード上に実装するものである。

[0010]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状によれば、アイランド端ハーフエッチング部および端子端ハーフエッチング部の断面形状を、モールド樹脂にて支持できるように形成したので、端子部の耐摩耐力が向上し、

ワイヤ断線や入腐食の発生を防ぐことができ、品質を向上することができるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るICカードモジュール用リードフレーム形状の一実施例を備えたICカードモジュールを示す断面図である。

【図2】図1のICカードモジュール用リードフレーム形状の製造工程を示す断面図である。

【図3】従来のICカードモジュールを示す平面図および断面図である。

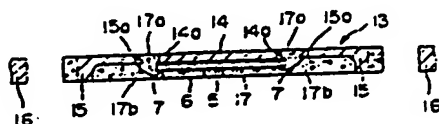
【図4】図3のリードフレームを示す平面図である。

【図5】図3のリードフレームの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

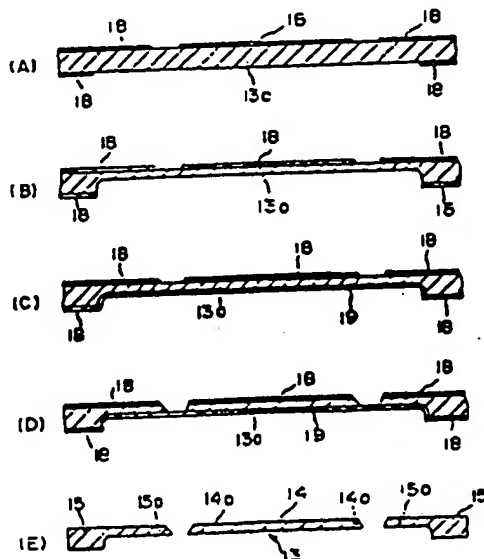
- 5 半導体素子
- 13 リードフレーム
- 14 アイランド
- 15 端子
- 16 外枠
- 17 モールド樹脂
- 18, 19 レジスト

【図1】



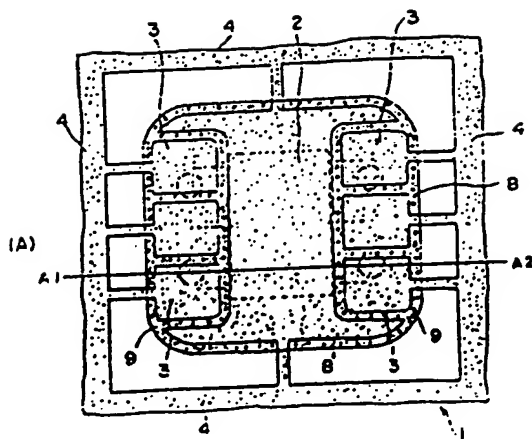
本発明のリードフレームを備えたICカードモジュールの断面図

【図2】



本発明のリードフレームの製造工程を示す断面図

[図3]



[図4]

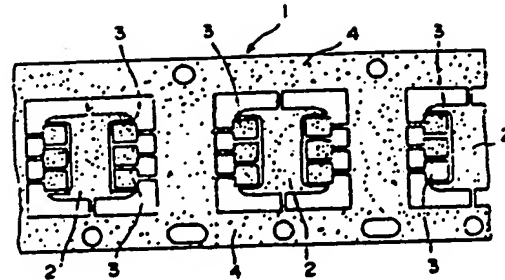
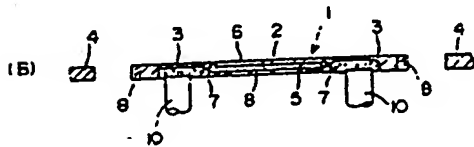


図3のV-フレームの断面図



この図に示すV-フレームの断面図

[図5]

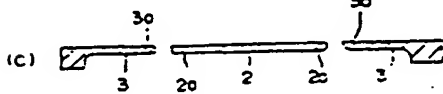
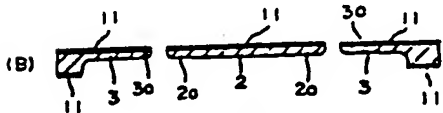
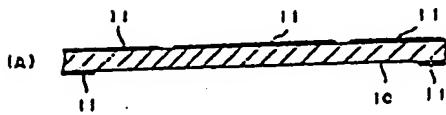


図3のV-フレームの断面図

(5)

特開平6-92076

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁴
H 01 L 23/50

特許庁内整理番号
H 9272-4M

F 1

技術表示箇所